

LC-4NT252

パッケージ基板コア層LTH用途
高生産性 高精度CO2レーザ穴明機

高生産性量産マシンで
最高水準の高精度加工を実現

NEW
新製品



業界最高水準の高精度穴位置精度を実現

□パッケージ基板コア層のレーザスルーホール (LTH) に最適

高密度パターンにおける穴位置要求精度が厳しくなるなか、高剛性機械構造および各種補正システムにより業界最高水準の加工穴位置精度を実現。

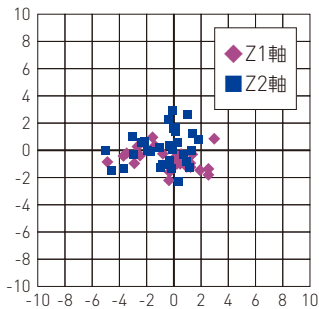
□高生産性

量産に最適な4ビーム/2パネル構成
 自社製高速ガルバノミラー、高出力レーザー搭載
 独自のXYテーブル、ガルバノ同期制御による加工速度向上

□高精度

特殊駆動系により機械コーニングZERO化
 ガラマスタ合わせ精度；Ave+4σ ≤ 8um
 LTH表裏合わせ精度；Ave+4σ ≤ 15um

ガラマスタ合わせ精度

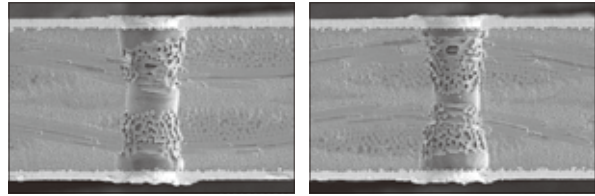


Ave+4σ ≤ 8um達成

	dX	dY	dR
Max.	3.10	2.80	5.00
Min.	-5.00	-2.40	0.10
Average	-0.38	-0.32	1.97
Sigma	1.91	1.12	1.10
Ave.+4sigma	8.01	4.80	6.37

(um)

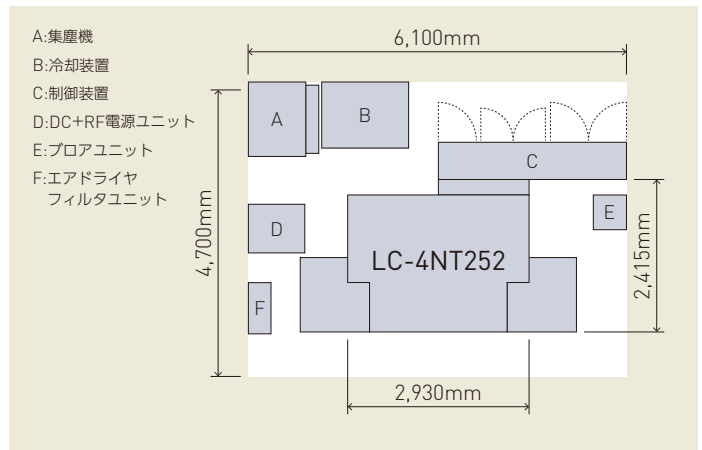
Cuダイレクト加工 (B.O.)



新型CNC MARK-55L



設置スペース



LC-4NT252/主仕様

項目	内容
最大加工エリア	620×620mm
XY早送り速度	50m/min
ビーム数	4
スキャンエリア	50×50mm



ビアメカニクス株式会社

本社/東日本支店：〒243-0488 神奈川県海老名市上今泉2100番地
 TEL. 046-235-9672 FAX. 046-235-9673
 西日本支店：〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄 4丁目6番15号
 TEL. 052-262-0621 FAX. 052-262-0625
<http://www.viamechanics.com>

